

英國PDR 紅外線BGA · SMD元件拆焊系統

IR-8000/IR-1100

特點

- 經濟型紅外線拆焊系統可拆焊SMD及BGA元件。
- 紅外線加熱，避免傳統熱風拆焊機罩住元件加熱，熱衝擊較大缺點。
- 非傳統式熱風拆焊系統，無熱風流動，不影響周邊元件，不會造成移位。
- 手握式紅外線燈，不用調整即可使用。
- 主機採用數位顯示，薄膜按鍵調整，可調整紅外線溫度及計時器定時時間。
- 主機功能有獨立紅外線拆焊、正數計時+紅外線拆焊、倒數計時+紅外線拆焊。
- 計時器功能可以正數計時及倒數計時，用於精確控制拔取零件所需的紅外線加熱時間。
- 智慧報警功能有聲音報警、LED燈光報警。用於提醒作業人員拔取零件時間到。
- 本機需要與IR620預熱系統配套使用。
- IR1100為簡易型手握式BGA拆焊系統
- IR8000則加上電路板支架及IR握把支架跟散熱風扇可免除操作人員操作之疲勞
- 附件以圖示為準



IR-8000



IR-1100

規格表

型號	IR1100/8000紅外線拆焊系統
電源	230V或115V
電源保險絲	T2A(230V)或T3.15A(115V) (慢速型)
輸出電壓	15VAC
輸出功率	150W
紅外線溫度	45°C-450°C (113°F-842°F)
定時範圍	0-900s
外型尺寸	170x100x200mm(W x H x D)
重量	3.3kg

配件表: IR620 PCB IR1100/ IR810 支架

配件表: IR8000/ IR810 IR620 XY600大型PCB支架 XY001離子散熱風扇
IR1100/ IR810 R620 及小型PCB支架

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)